Systemdatenblatt

SL Floor WHG AS 01

Positionen

Stahlkugelstrahlen von mineralischen Flächen

Grundierung mit einem WHG- und DIBt-geprüftem 2-K EP-Bindemittel

mind. 0,30 kg/m² Epoxy GL 100 <1427> (je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)

*** Grundposition

Egalisierung von Rauigkeiten mit einem WHG- und DIBt-geprüftem 2-K EP-Bindemittel (<1 mm)

ca. 0,5 kg/m² Remmers Epoxy GL 100 <1427>

ca. 0,50 kg/m² Remmers Selectmix 01/03 <4405>

Leitfähige Querleitschicht aus einem wässrigen 2-K EP- Bindemittel inkl. Erdungselementen

mind. 0,15 kg/m² Remmers Epoxy Conductive LE <6701> ca. 0,1 - 0,5 m/m² Remmers Kupferlitze <4551>

Remmers Remmers Leitset <4933>: Die Gesamtanzahl der Anschlusspunkte ist abhängig: - von der Größe und Geometrie der Fläche - max. Abstand der Kupferlitzen Erfahrungswert: 2 Erdungspunkte pro 100 m²

Beschichten mit einem rissüberbrückenden, pigmentierten, ableitfähigen WHG- und DIBt-geprüften 2-K EP-Bindemittel

1,5 kg/m² Remmers Epoxy WHG Color AS (bei senkrechten Flächen ist anteilig Remmers WHG TX zuzugeben): ca. 1,5-2,5 % bez. Auf die Bindemittelmenge

Einblasen von Struktur-/Mattierungsmittel

ca. bzw. bis zu 0,05 kg/m² Remmers Glimmer GHL 3/0 <6742>